

碳化硅颗粒增强铝合金复合材料特性

王治海

(中南工业大学粉末冶金研究所, 长沙 410083)

摘要 用粉末冶金和热挤压工艺制备了碳化硅颗粒增强铝基复合材料。研究了碳化硅颗粒的体积分对复合材料性能的影响。

关键词 碳化硅 颗粒增强 铝合金 复合材料

金属基复合材料的研究开始于60年代初期。70年代中期用稻谷壳制取SiC晶须获得突破后,晶须增强铝合金的复合材料研究成了美国、日本的热门课题^[1-3]。经过10多年的研究,美日在材料的应用上有了突破性的进展,例如用该复合材料制造活塞顶盖、活塞及活塞连杆。到80年代后期特别是近些年,人们转向用陶瓷粒子作增强剂,制取颗粒增强铝基复合材料^[4,5]。其方法有:高压金属液流浸渗陶瓷预制件;金属-陶瓷粒子熔融铸造;粉末冶金方法。粉末冶金方法有其优点:(1)烧结温度低于熔炼温度,避免不利反应;(2)陶瓷粒子添加量可以在较大范围内改变;(3)粒子分布均匀^[6,7]。

本文用粉末冶金方法制备碳化硅颗粒(SiC_p)增强铝合金复合材料,并探讨SiC_p体积分数的改变对复合材料性能的影响。

1 实验过程及方法

1.1 实验工艺流程设计

SiC_p/Al-Cu 复合材料制备工艺流程如下:

Cu粉、Al粉、SiC粉→超声波湿混→干燥过筛→混合粉末→预成形→N₂烧结→热压→热挤压→试样(或热处理→试样)

1.2 原料及其性能

本实验用的SiC颗粒是通过热分解稻谷壳制得β-SiC,其性能如表1。

表1 β-SiC颗粒的部分性能

| 晶体类型 | 立方晶系 |
|---|-------|
| 颗粒直径/μm | 1.73 |
| 密度/g·cm ⁻³ | 3.2 |
| 热膨胀系数 /10 ⁻⁶ ·C ⁻¹ (20~1000 C) | 4.5 |
| 显微硬度/MPa | 32730 |
| 弹性模量/GPa | 394 |
| 抗压强度/MPa | 2210 |

所用基体为N₂气雾化快冷制得的-325目的铝粉和-200目电解铜粉的混合粉末,其成分为:Al-4.4%Cu。

1.3 试样制备

将混合料在钢模中冷压成形,压坯尺寸为d 25 mm×30 mm,在通N₂气的加热炉中预烧,烧结温度为630±5℃,保温30 min后放入预热到400℃的钢模中热压,压力为360 MPa。压坯相对密度在92%以上。压坯再加热到580℃进行热挤压,压力为800 MPa,挤压比为10:1,最终试样直径为8 mm。

1.4 性能检测

SiC_p/Al-Cu复合材料的抗压强度在国产WD-100B万能电子拉伸机上测得。测量时的拉压速度为0.5 mm/min,所用试样高径比为1.5,试样直径为6 mm。

室温硬度在HD1-1875型布洛维硬度计上用1.563 mm钢球在负荷为1000 N,加载时间为10 s的条件下测得。

热膨胀系数在TA-1500型热膨胀仪上测

定。评定复合材料的耐磨性是用直径6mm,长15mm的销子在MG-200型高速高温磨损摩擦试验机上与摩擦对偶件干磨(对偶件为灰口铸铁),以试样前后的重量损失来衡量耐磨性的好坏。

为了研究热处理对SiC_p/Al-Cu复合材料机械性能的影响,对材料进行T6处理(510±5℃,60min固溶处理,160℃时效18h)。

2 实验结果与讨论

2.1 SiC 颗粒体积分数对复合材料力学性能的影响

表2、表3分别给出SiC_p体积分数不同的复合材料在挤压态和T6态的力学性能。

表2 SiC_p 体积分数对挤压态

SiC_p/Al-Cu 复合材料力学性能的影响

| SiC _p /% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 密度/g·cm ⁻³ | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.79 | 2.74 | 2.82 | 2.77 | 2.89 |
| 抗压强度/MPa | 506 | 532 | 601 | 652 | 639 | 690 | 680 | 880 |
| σ _{0.2} /MPa | — | 243 | 294 | 340 | 375 | 378 | — | 660 |
| 压下率/% | 48.4 | 41.7 | 32.4 | 31.1 | 24.0 | 22.4 | 16.0 | 14.9 |
| HRB | 41.0 | 43.0 | 44.5 | 49.5 | 55.5 | 63.0 | 67.5 | 69.5 |

表3 SiC_p 体积分数对T6态

SiC_p/Al-Cu 复合材料力学性能的影响

| SiC _p /% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 密度/g·cm ⁻³ | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.79 | 2.74 | 2.82 | 2.77 | 2.89 |
| 抗压强度/MPa | — | — | — | 803 | 708 | 829 | 804 | 943 |
| 压下率/% | 40.0 | 36.1 | 31 | 3.03 | 23.6 | 22.1 | 15.3 | 12.3 |
| HRB | 65 | 66 | 67.5 | 68.5 | 73.5 | 78.0 | 85.0 | 86.0 |

用该工艺制作的复合材料其密度均大于99%。复合材料的抗压强度、屈服强度和硬度,均随碳化硅粒子体积分数的增加而增加。而塑性(压下率)随SiC体积分数增加下降。

经过T6处理的复合材料其抗压强度、硬度有较大幅度提高。

SiC_p/Al-Cu 复合材强度增加按照Orowan弥散强化位错机构^[8],由于弥散的第二相粒子的硬度远较基体合金高,位错线不能直接切割第二相粒子,在外力作用下,位错线环绕第二

相粒子发生弯曲,位错区的晶格发生畸变,增加了能量,使位错滑移抗力增大,从而提高复合材料的屈服强度。弥散相的含量、粒度和粒子间距的关系符合:λ = 2/3d(1/f - 1),式中

λ是粒子间距,f是弥散相的体积分数,d为粒子直径。在SiC_p增强的复合材料中,粒子直径越小,SiC_p颗粒体积含量越高,则粒子间距越小,材料强度越大,这与本实验结果是一致的。SiC_p粒子与基体合金热膨胀系数相差极大,因此,在粒子的周围将产生极大的热应力差,聚集高位错密度,这也是增强的因素。经T6处理后材料硬度强度均有提高,这与基体的时效硬化有关。基体材料经时效后,第二相CuAl₂质点产生沉淀硬化效应。

2.2 复合材料的弹性模量

SiC_p体积分数对复合材料弹性模量的影响见表4。

表4 SiC_p/Al-Cu 复合材料弹性模量

| SiC _p 体积分数/% | 弹性模量/GPa | |
|-------------------------|----------|---------|
| | 挤压态 | T6态 |
| 0 | 73 | 73 |
| 15 | 89~97 | — |
| 20 | 97~117 | 97~117 |
| 25 | 117~151 | 117~151 |

从表4可知, SiC颗粒的加入使材料的弹性模量升高。这是由SiC颗粒本身弹性模量远高于基体合金的缘故。经T6处理后材料的弹性模量并不改变。

2.3 复合材料的热膨胀系数

表5给出了复合材料的热膨胀系数值。热膨胀系数值随SiC_p体积分数增加而下降。由于SiC的热膨胀系数为4.5×10⁻⁶/℃,比基体合金小一个数量级,因此加SiC必然带来低膨胀系数。

据文献[9],当组成复合材料的各相的热膨胀系数差别较大时,其热膨胀系数α_c符合下式:

$$\alpha_c = \alpha_m - AV_d(\alpha_m - \alpha_d) \quad (1)$$

式中 α_m为基体相的膨胀系数;α_d为弥散相的膨胀系数;V_d为弥散相所占的体积百分数;A

为与弹性模量有关的常数。

表5 SiC_p/Al-Cu 复合材料热膨胀系数(10⁻⁶ C⁻¹)

| SiC _p 体积 分数/% | 热膨胀系数 | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | 室温~100 C | 室温~200 C | 室温~300 C |
| 5 | 21.46 | 23.44 | 25.05 |
| 10 | 20.81 | 23.63 | 23.24 |
| 20 | 20.85 | 23.00 | 21.89 |
| 30 | 17.34 | 18.13 | 18.63 |
| 40 | 14.16 | 15.40 | 15.52 |

由式(1)可知,复合材料的膨胀系数 α_c 与材料中弥散相所占的体积百分数 V_d 成正比。本实验中除了个别数据由于测量的原因反常外,基本符合上述关系。

2.4 复合材料的耐磨性

表6给出了复合材料的耐磨试验结果。

表6 SiC_p/Al-Cu 复合材料耐磨损试验结果

| SiC _p 体积分数/% | 磨损量/mg |
|-------------------------|--------|
| 20 | 20.0 |
| 30 | 5.2 |
| 40 | 1.0 |

从表6可以看出,复合材料的耐磨性明显高于基体合金,并随着SiC含量增加,耐磨性能显著增加,即材料的磨损量显著减少。这种关系的存在,主要决定于SiC颗粒的优越耐磨特性。

3 结论

(1) 用粉末冶金法可以制备含SiC颗粒体积分数大(40%)的复合材料,经热挤压, SiC_p可均匀弥散在基体材料中。

(2) 复合材料的强度、硬度、耐磨性均随SiC_p体积分数增加而增加,塑性、热膨胀系数随SiC_p体积分数增加而降低。

(3) T6处理可明显提高复合材料的强度,与挤压态相比,强度约提高17%~36%,而塑性有所降低。

参考文献

- 1 吴人洁. 复合材料学报, 1987, 9: 1-9.
- 2 Trumper R L. Metals and Materials, 1987, 11: 662-667.
- 3 Bonnon J J *et al.* Mat Trans, 1991, 122A (5): 1007-1019.
- 4 白春涛. 材料工程, 1989, 1: 44-47.
- 5 Mlshra R S *et al.* Mat Trans, 1990, 21A (7): 2089-2090.
- 6 Arsenault R J *et al.* Scripta Met, 1989, 22: 767-772.
- 7 Fishnan S G *et al.* Journal of Metals, 1981, 12: 11-17.
- 8 黄培云主编. 粉末冶金原理. 北京: 冶金工业出版社, 1982: 387-405.
- 9 徐京娟等. 金属物理性能分析. 上海: 上海科技出版社, 1988: 102.